

**DIAPOL 509**

RESINA PU FLEXIBLE

CLASE TÉRMICA: B (130°C)

POLIMERIZACIÓN AL AIRE

✓ Gran adherencia a distintos materiales

✓ Mantiene la flexibilidad a temperaturas bajo cero

**CAMPO DE APLICACIÓN**

Resina de colada bicomponente para múltiples aplicaciones eléctricas y electrónicas (ej.: reactancias, arrancadores, condensadores, canalizaciones, empalmes subterráneos, electroimanes, etc.).

**MODO DE EMPLEO**

Debe homogeneizarse antes de ser empleada y se puede mezclar con su catalizador a temperatura ambiente, según la dosificación 100/10 en peso. Para conseguir una mejor calidad en el acabado de la aplicación, recomendamos precalentar la resina a 50°C aprox. El empleo de máquinas mezcladoras-dosificadoras automáticas, favorece la manipulación de este producto. Si se desea desencapsular la resina polimerizada, se deberá aplicar nuestro agente desmoldeante en el molde. Para piezas encapsuladas donde se requiera presentar máximas características eléctricas recomendamos realizar la colada bajo vacío. La resina en su recipiente original y precintado tiene un tiempo de vida garantizado de un año.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

	DIAPOL 509	CATALIZADOR 500	MEZCLA 100/10
Viscosidad a 25°C (mPa.s)	12000 ± 2000	200 ± 50	10000± 2000
Densidad a 20°C (g/cm <sup>3</sup> )	1.55 ± 0.04	1.23 ± 0.01	1.52 ± 0.02
Pot Life a 25°C (min)	120-140		
Polimerización total	10h. a 60°C		
Dureza Shore A	80		
Resistencia a la tracción (MPa)	1.8		
Alargamiento a la rotura (%)	10		
Absorción agua 24h, 20°C (% peso)	0.1-0.2		
Rigidez dieléctrica, 50Hz, 20°C (KV/mm)	15		
Resistencia superficial (Ohm)	n.d.		
Resistencia específica (Ohm.cm)	n.d.		
Constante dieléctrica, 50Hz, 20°C	4.2		
Resis. defor. térmica Pto. Martens (°C)	20		
Conductividad térmica (W/mK)	0.5-0.6		

**FORMA DE SUMINISTRO**

En bidones metálicos de 1, 5, 25, 140, 300 Kg y contenedores de 1000Kg.

Rev. Octubre 2019  
Versión: 2

La información que les ofrecemos es de carácter informativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.